

**Investor Relations 2023**



**LB**Semicon

# Disclaimer

## \*\*\*

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 LB세미콘 주식회사(이하 "회사")에 의해 작성되었으며  
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한  
위반에 해당될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및  
재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며,  
본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.  
또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에  
따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가  
될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.



# ★ Contents

<b>1. Introduction</b> .....	<b>3</b>
Prologue .....	4
Company Overview .....	5
Milestone .....	6
Business Portfolio .....	7
Service Flow .....	8
Business Chain .....	9
<b>2. Competitiveness</b> .....	<b>10</b>
Vision .....	11
Customer Diversification .....	12
Application Diversification .....	13
Process Diversification .....	14
Business Diversification(Subsidiaries) .....	16
<b>3. ESG</b> .....	<b>17</b>
Sustainability .....	18
<b>4. Financials</b> .....	<b>19</b>
Financial Highlights .....	20
<b>5. Appendix</b> .....	<b>23</b>
Summary of Financial Statements .....	24



# 1. Introduction

Prologue	4
Company Overview	5
Milestone	6
Business Portfolio	7
Service Flow	8
Business Chain	9

목차로 이동

# Prologue



**LB**Semicon

**진보된 기술력과 도전 정신으로  
반도체 분야의 혁신을 주도하는 OSAT 전문 기업**

## **Bump 공정, Probe Test 및 Assembly 일부 공정 사업 영위**

2000년 2월, 국내 최초로 필요한 모든 생산설비를 갖추고 flip-chip wafer bumping 사업 시작  
Gold bumping을 시작으로 Solder bumping, CPB, 나아가 WLP까지 flip-chip bumping 기술을 지속적으로 개발  
진보된 기술력과 끊임없는 도전정신을 기반으로 국내외 우수 반도체 Chip Maker와의 탄탄한 글로벌 사업 파트너로 성장하며 지속적인 관계를 유지  
반도체 제조기술 트렌드(경박단소화)에 따라 wafer bumping 기술은 더욱 활용가치가 높아지고 있으며, 끊임없는 연구 및 기술 개발을 통해 앞으로 나아가는 중

\* OSAT : Outsourced Semiconductor Assembly and Test

# Company Overview



## ★ Company Overview

\* 2023. 09. 30 기준

회사명	LB세미콘(주)
설립일	2000년 2월 10일
대표이사	김 남 석
자본금	219 억원
임직원수	686 명
주요제품	Bumping, Probe Test, Back-end
주소	경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138
평택공장	경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138
안성공장	경기도 안성시 공단1로 10
홈페이지	www.lbsemicon.com

## ★ CEO



**대표이사 김남석**

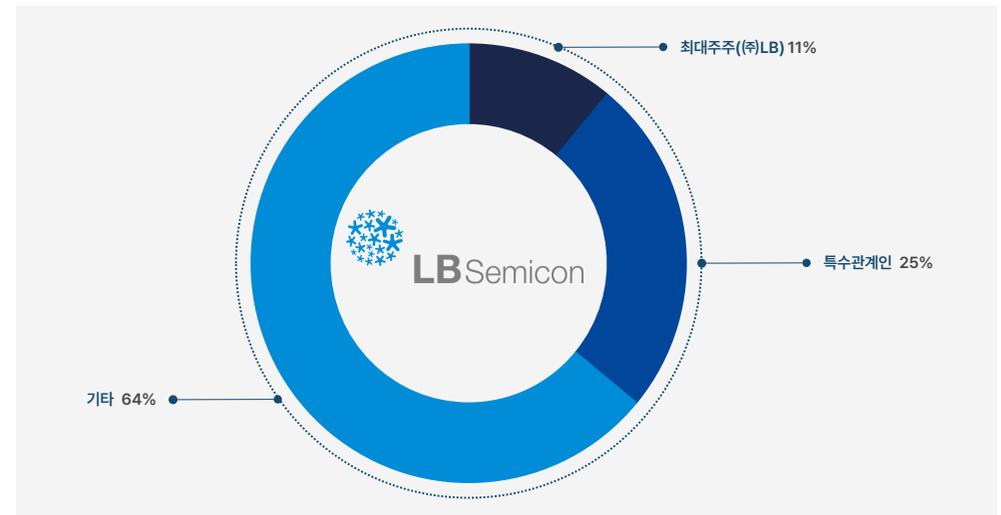
서울대학교 금속공학과 박사

삼성전자

SK 하이닉스

現 LB세미콘(주) 대표이사

## ★ Shareholder Status



# Milestone

## EMBARKING ON A JOURNEY

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
마이크로스케일(주) 회사설립	삼성전자 EDS TEST 양산 개시	삼성전자 Bump 양산 개시	제40회 무역의 날 500만불 수출의 탑 수상		최대주주 변경 (구본천)	LB세미콘(주) 사명변경 MagnaChip 양산 개시 Silicon Works 양산 개시	Solder Bump 양산 개시	Back-end Service 시작	WLCSP 제품 출하	딜로이트 아시아 태평양 지역 기술부분 500대 기업 선정

## LEAPING FORWARD TO THE FUTURE

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
코스닥 시장 상장	Himax 양산 개시 PMIC TEST 양산 개시	SK hynix CIS TEST 양산 개시 12" Bump 양산 개시	Thick Cu 양산 개시	High Current WLCSP 양산 개시	NOVATEK 양산 개시	기술평가 우수기업 인증	LB Lusem 인수	ISO 45001:2018 인증		Fan-out WLP 개발 완료	삼성전자 AP, CIS TEST 양산 개시	LB ReTech 인수

# Business Portfolio

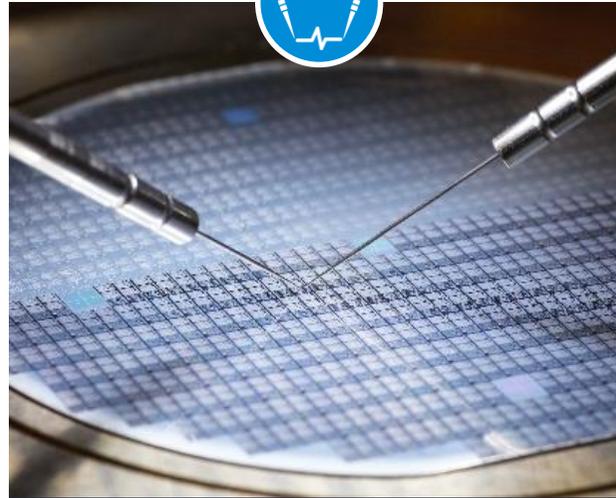


**Bumping 공정**

반도체 칩에 돌기(Bump)를 만들어 기판과 전기적, 기계적으로 연결하는 공정

기존 wire bonding기술 대비 I/O 개수와 위치가 제약이 없어 칩 크기를 축소할 수 있으며, 신호 전달 경로가 짧아 전기적 신호가 신속하게 전달됨

LB세미콘은 Au Bump, Solder Bump, Cu Pillar Bump, FI-WLP, RDL 등의 Bumping 서비스 보유

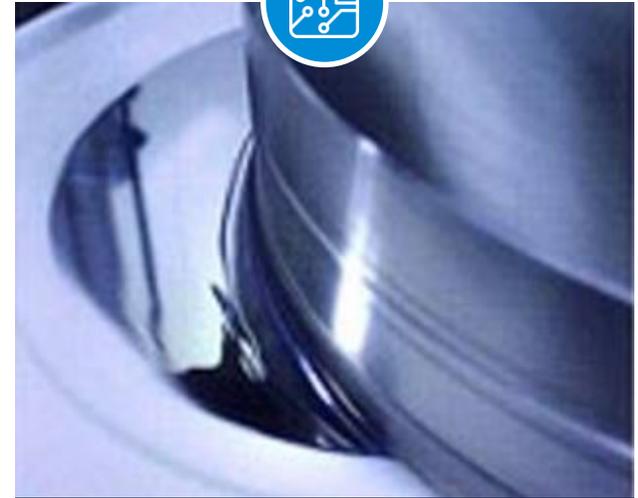


**Test 공정**

Wafer test는 wafer 상에서 개별 반도체 칩의 전기적 성능과 품질을 검사하는 공정

LB세미콘은 전량 Wafer Test (Probe Test)를 진행 온도, 속도, 동작 test로 불량 칩을 선별할 수 있어 후속 공정 효율성 향상 가능

LB세미콘은 DDI, PMIC, CIS, SoC 전용 Tester를 보유



**Back-end 공정**

Bumping 공정 이후 개별 칩으로 나누는 공정

세부 공정인 Back Grinding – Laser marking – Sawing 등을 통해 wafer level 칩들을 단일 칩으로 나눔

LB세미콘은 개별 칩을 DDI의 경우 Pick & Place 공정, PMIC의 경우 Tape & Reel 공정을 통하여 제공

# Service Flow



## ★ Bumping

### WLP

- FIWLP
- FOWLP

### RDL

- Direct RDL
- Au RDL

### AU BUMPING

- Gold Bump

### SOLDER BUMPING

- Solder Bump
- Cu Pillar Bump
- Cu-Ni-Au Bump

## ★ CP-Test

### CP-TEST

#### (Chip Probe – Test)

- DDI
- PMIC
- CIS
- SoC
- RE-CON

## ★ Back-end

### BACK-END

- Laminating
- Back Grinding
- Back Side Coating
- Laser Marking
- Foil Mount
- Laser Grooving
- Dicing Sawing
- Plasma
- Post AVI
- UV Irradiation
- Pick & Place
- Tape & Reel
- AVI Visual Inspection
- Packing

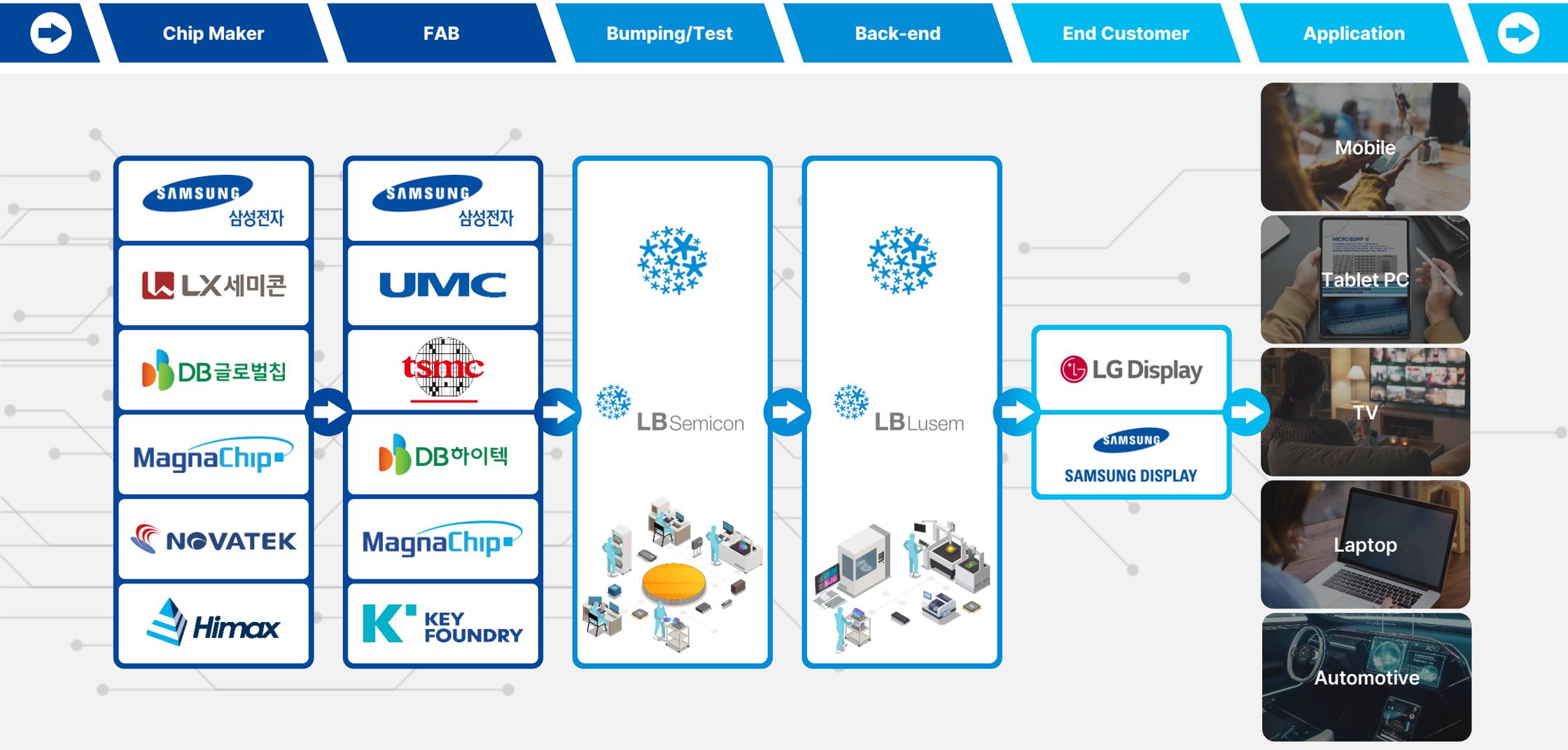


LB세미콘은 Total Solution을 기반으로 고객 맞춤형 서비스를 제공

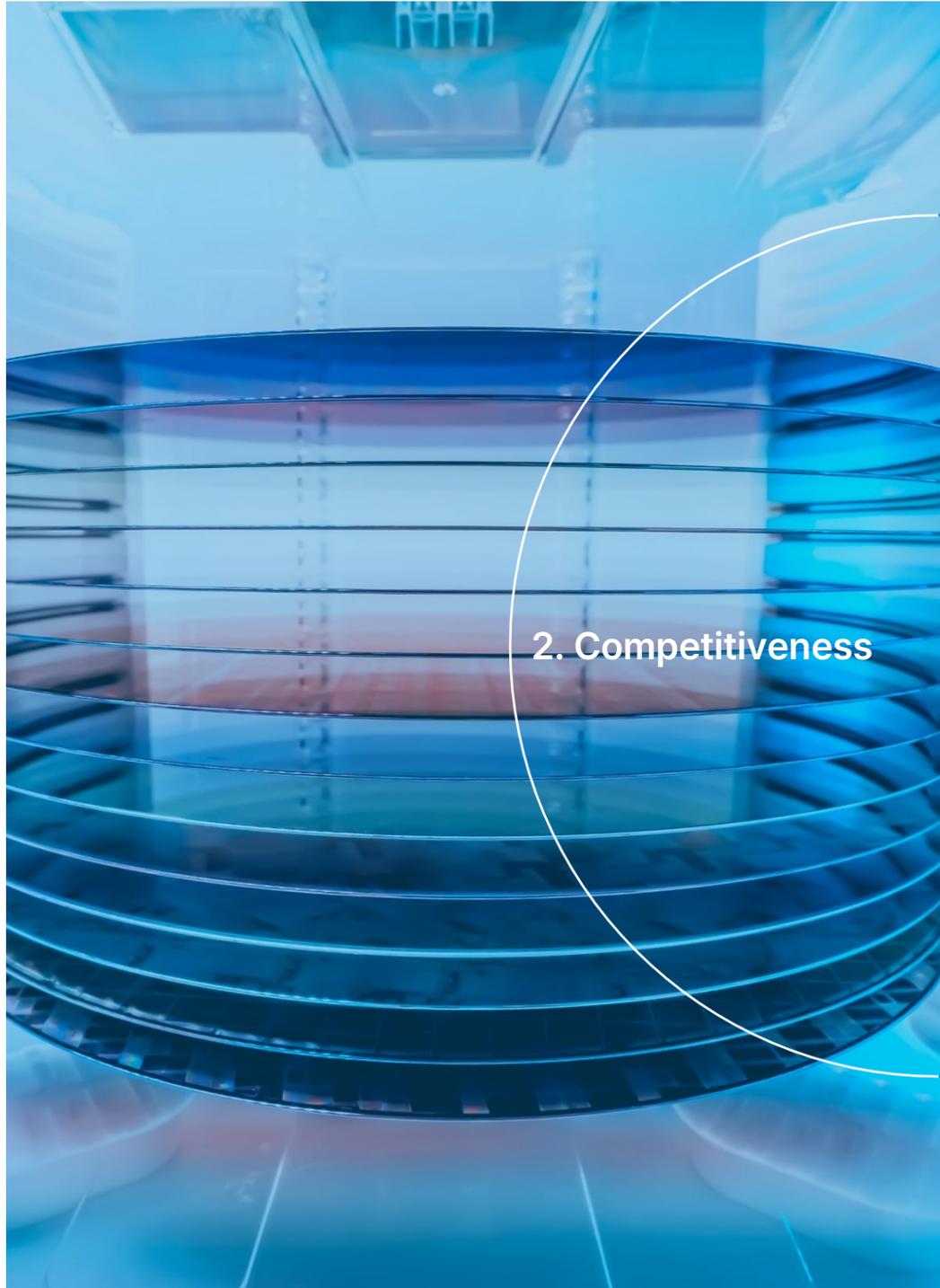


# Business Chain

## Display Driver IC Value Chain



DDI Bumping 사업의 경우 디스플레이 및 디스플레이 소재/부품사업자와의 Network가 중요



## 2. Competitiveness

<b>Vision</b> .....	<b>11</b>
<b>Customer Diversification</b> .....	<b>12</b>
<b>Application Diversification</b> .....	<b>13</b>
<b>Process Diversification</b> .....	<b>14</b>
<b>Business Diversification(Subsidiaries)</b> .....	<b>16</b>

목차로 이동

# Vision

★  
Look Beyond,  
Best Solution Provider

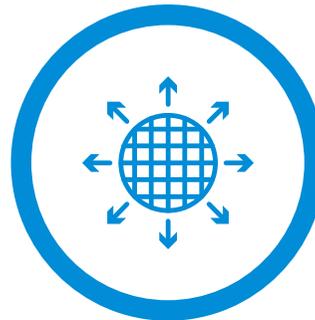
2025 Vision 달성  
Global OSAT Top 10



Customer Diversification

Accompanying

# 존중 # 행복



Application Diversification

Challenging

# 변화 # 도전



Process Diversification

Talent

# 열정 # 인재 중시

# Customer Diversification



## Customer Diversification

고객과 함께 성장하는 LB세미콘

반도체 후공정 분야는 안정적인 거래선 발굴로  
가동률을 높이는 것이 수익성에 큰 영향을 주는 업종이므로,  
다변화된 고객군을 형성하는 것은 대외적인 경기 변동 상황에서도  
높은 수익률을 확보하는 중요한 키로 작용

LB세미콘은 기존 고객과의 밀접한 협력을 유지하면서도,  
해외 대형 Fabless 업체로 고객군을 확장하여  
고객 포트폴리오를 다양화할 계획

현재 다양한 신규 고객과 긴밀한 협의 중



[해외 신규 고객 확보를 통한 매출 증대]



# Application Diversification



## Application Diversification

Application 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는 LB세미콘

전체 반도체 시장의 75%를 차지\*하는 비메모리 반도체 시장에는 다양한 application이 존재

LB세미콘 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 DDI 외에도, PMIC, CIS, SoC 등의 경쟁력을 강화하여 Non-DDI 비중을 지속적으로 증가시켜 더욱 강력한 비즈니스 경쟁력을 구축할 예정

2022년 전체 반도체 시장 규모: 5,996억 달러  
 (메모리 반도체 시장 규모: 1,432억 달러 (24%) 비메모리 반도체 시장 규모: 4,564억 달러 (76%))  
 (출처: Gartner, 23.05)



● DDI ● PMIC ● CIS ● SoC

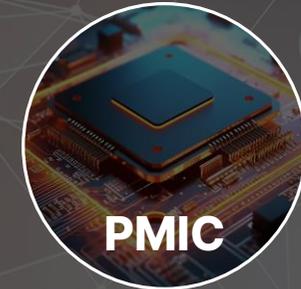
[Non-DDI 비중 확대를 통한 매출 증대]



**DDI**

Display Driver IC.

OLED, LCD 등의 디스플레이를 구성하는 수많은 픽셀을 구동하는 데에 쓰이는 작은 반도체 칩.  
TV, Mobile 등



**PMIC**

Power Management IC.

핵심 기능을 수행하는 주요 칩에 필요한 전원을 공급하는 반도체.  
Mobile, Wearable, Automotive 등



**CIS**

CMOS Image Sensor.

렌즈를 통해 들어온 상을 디지털 신호로 변환해 이미지로 보여주는 반도체.  
Mobile, Camera 등



**SoC**

System on Chip.

여러 가지 기능을 가진 시스템을 하나의 칩으로 구현한 기술집약적 반도체.  
TV와 Mobile AP 등

# Process Diversification



## Process Diversification

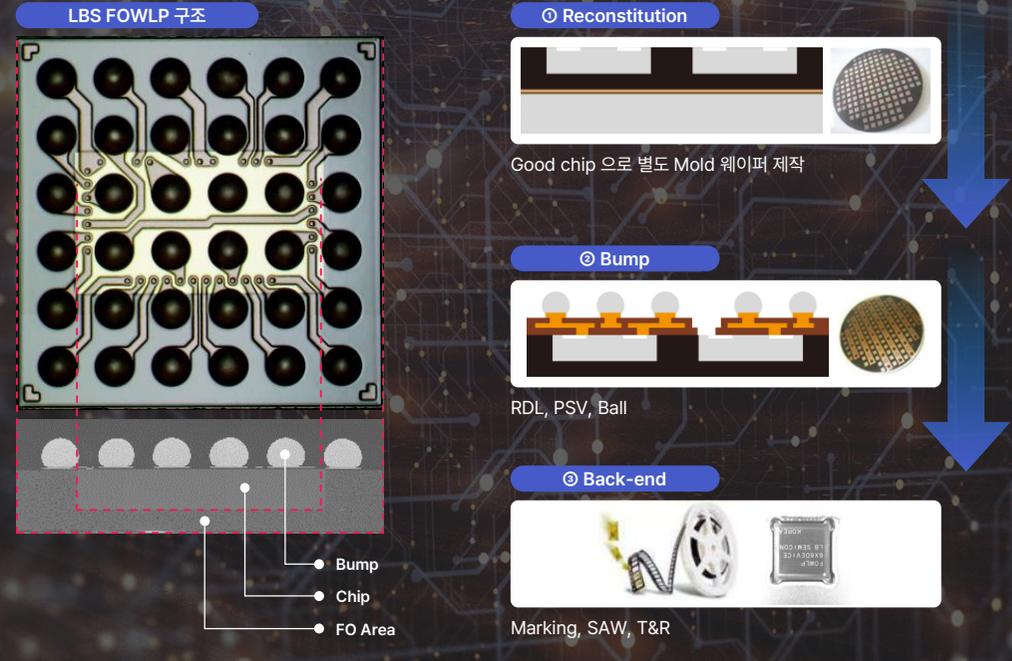
공정 다변화를 통해 변화에 대응하는 LB세미콘

패키징 공정은 최근 반도체 산업 내에서도 가장 빠른 변화를 마주하고 있는 분야  
전통적인 리드프레임 방식에서부터, 솔더볼/범프를 이용한 BGA/FC 등을 거쳐 현재는 고집적/다기능 소자 구현이 가능한 FOWLP 등의 첨단 패키징 기술로 빠르게 패러다임이 변화

단, 패키징의 경우 신기술이 기존 기술을 완전히 대체하지는 않으며, 각각의 기술별로 일부 소재 및 공정에 한해 신기술이 적용되는 등 다양한 난이도의 기술이 혼재되어 발전된다는 점이 특징  
LB세미콘은 범프부터 첨단 패키징인 FOWLP까지 고른 라인업을 구축해, 패키징 산업의 현재와 미래를 모두 대응해 나갈 계획



### LBS FOWLP 구조 및 공정



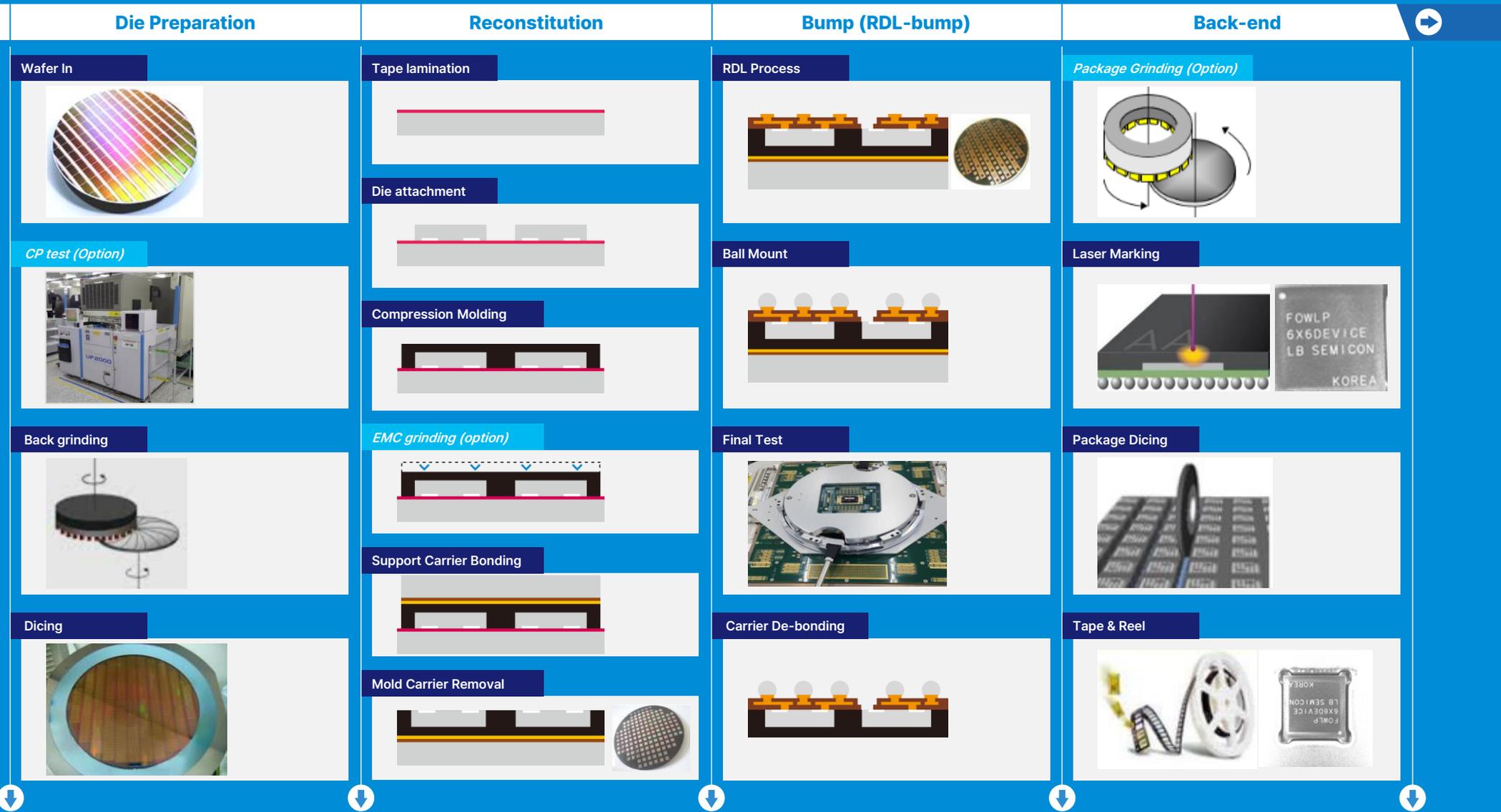
### LBS FOWLP의 차별점

Glass carrier & Laser de-bonding 적용으로  
Thin panel handling ( $\leq 350\mu\text{m}$ ), 원가 개선 (재사용)

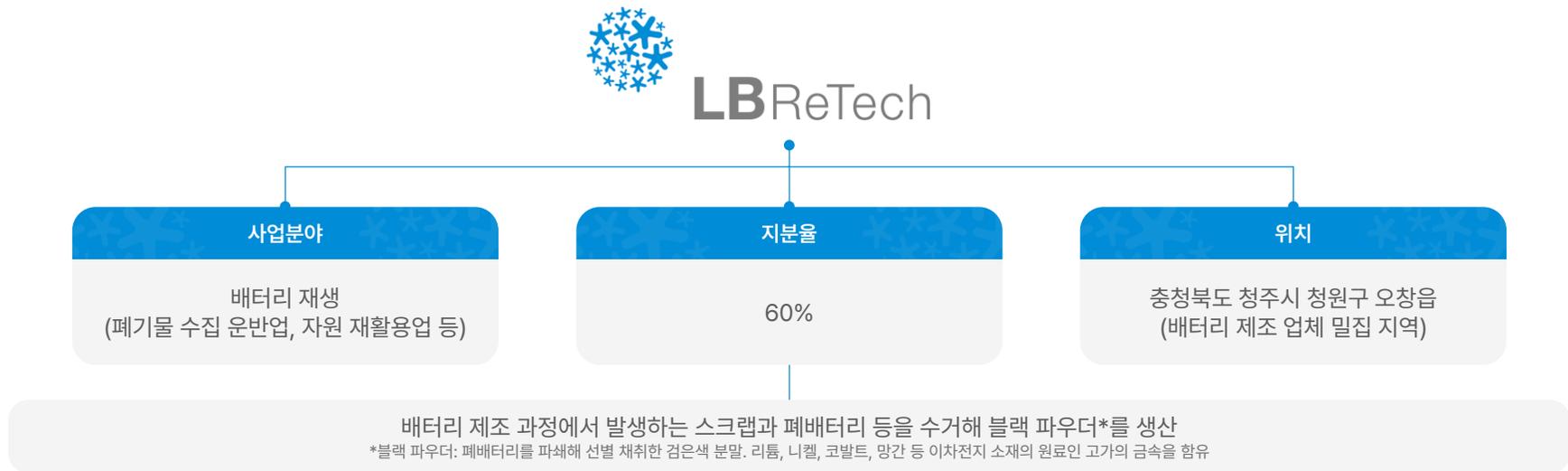
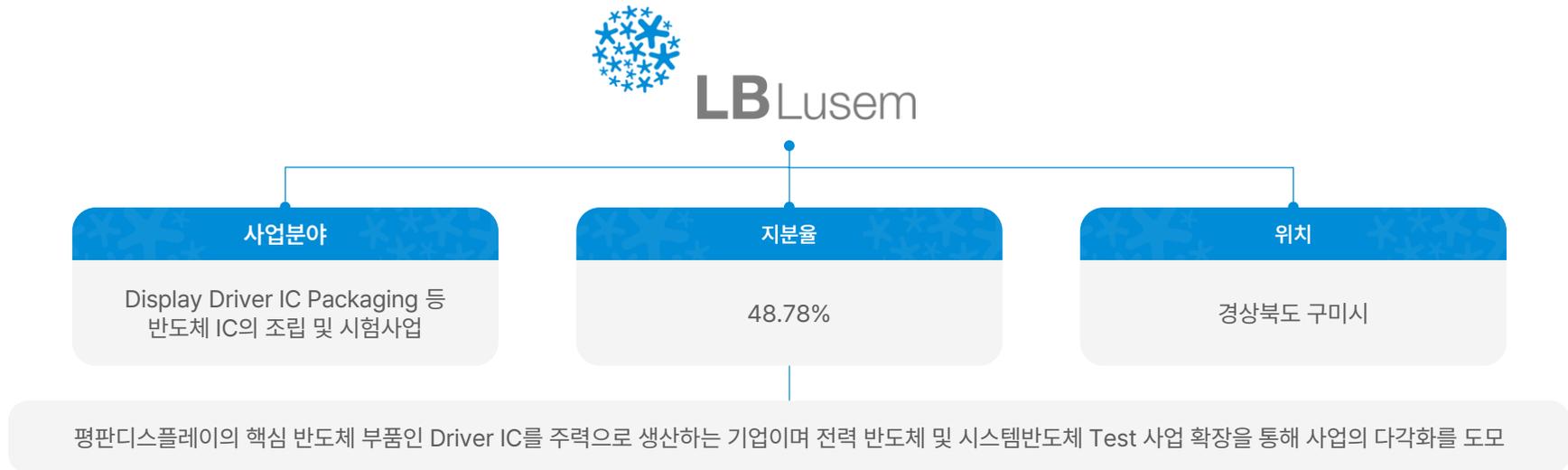
FOWLP: PCB 기판을 사용하지 않고 칩과 칩 바깥 영역의 입출력 단자를 연결함으로써 칩 대비 더 넓은 I/O 공간을 확보하여 전기적 성능 향상 구현  
Application : PMIC, RFIC

# Process Diversification

## LB Semicon FOWLP Process Flow



## Business Diversification(Subsidiaries)





3. ESG

Sustainability

18

목차로 이동

## Sustainability

### Environmental Responsibility

LB세미콘은 인류와 지구 환경의 지속가능한 공존을 생각합니다.

- 친환경 경영을 통해 기후변화 협약에 동참하고 자원을 재활용하여 환경에 미치는 영향을 최소화
- 환경 경영 시스템 인증서 ISO 14001:2015, 안전보건경영시스템 인증서 ISO 45001:2018, LG Display Carbon Partnership Certificate
- LB리텍 인수로 폐배터리 재사용 연구 진행 및 온실가스 관리, 폐기를 재활용, 수자원 재이용 등
- 2050년까지 재생에너지 100% 전환 계획



### Social Responsibility

LB세미콘은 사회와 함께 더 나은 내일을 만들어갑니다.

- 임직원과 협력사, 지역사회 주민 모두를 위한 안전한 사업장 구축
- 인권을 보장하는데 앞장서고 지역사회와의 협력 관계를 구축 및 강화
- SEC(미증권거래위원회)에서 실시하는 국제분쟁광물 사용 규제에 적극 동참
- 지역사회 환경 정화와 미화 활동 및 청·장년, 장애인 일자리 창출
- 지역 내 청소년 범죄활동 예방 후원
- 아동 청소년 후원, 문화 예술 후원 등

### Governance

LB세미콘의 사업 성장이 우리 모두의 지속가능한 미래를 만듭니다.

- ESG 지표 관리를 통해 윤리 경영을 추구
- 투명성과 독립성에 기반한 건전한 지배구조를 수립하고 모든 이해관계자들과 함께 성장 추구
- 전 임직원 대상으로 ESG 교육 실시
- 윤리 경영, 이사회와 환경·안전·보건 계획 논의, 대표이사와 이사회 의장 분리 등
- ESG TFT를 통해 환경, 인권, 안전보건, 사회적 책임, 고객 가치, 주주 가치, 지배 구조 등에 관련된 중장기 목표 수립

## 4. Financials

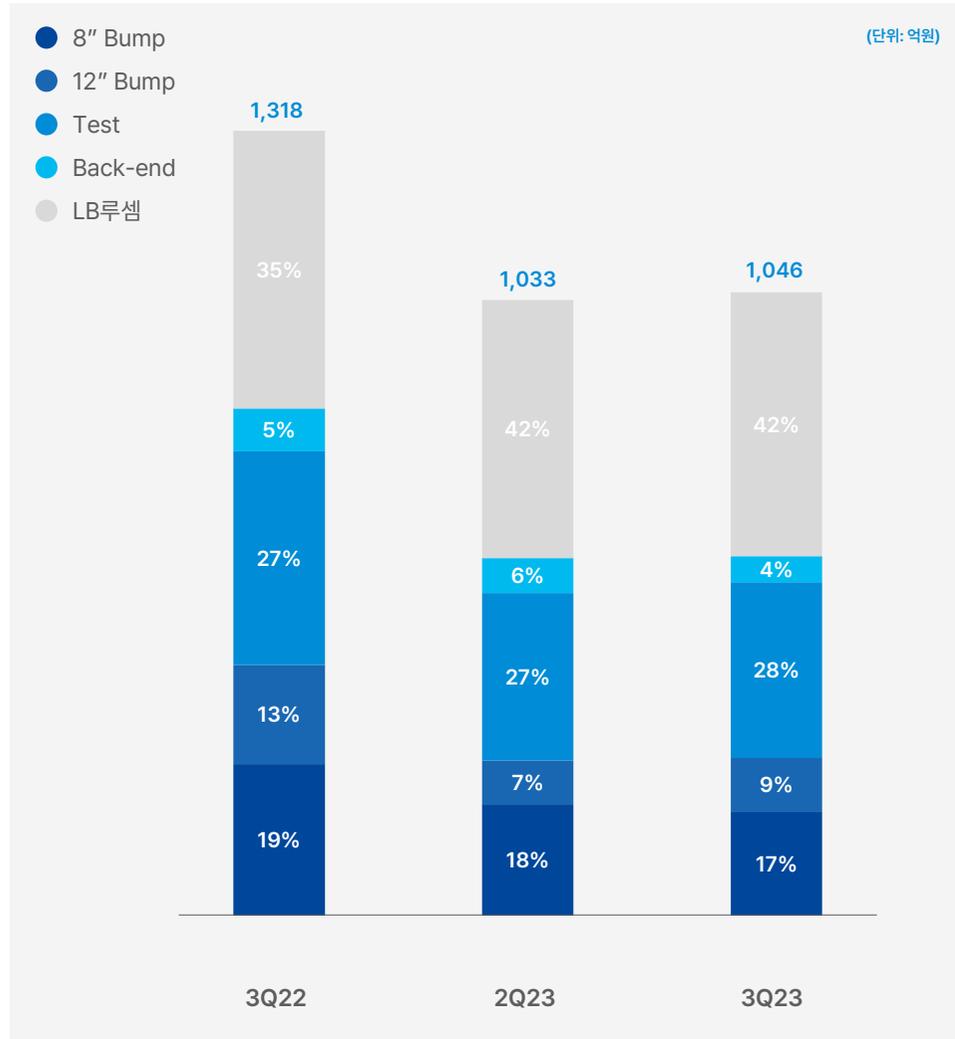
### Financial Highlights

a. 공정별 매출	20
b. 영업이익	20
c. 분기별 실적 비교(별도)	21
d. 분기별 실적 비교(연결)	21
e. Application별 매출(별도)	22
f. 제품별 매출(별도)	22

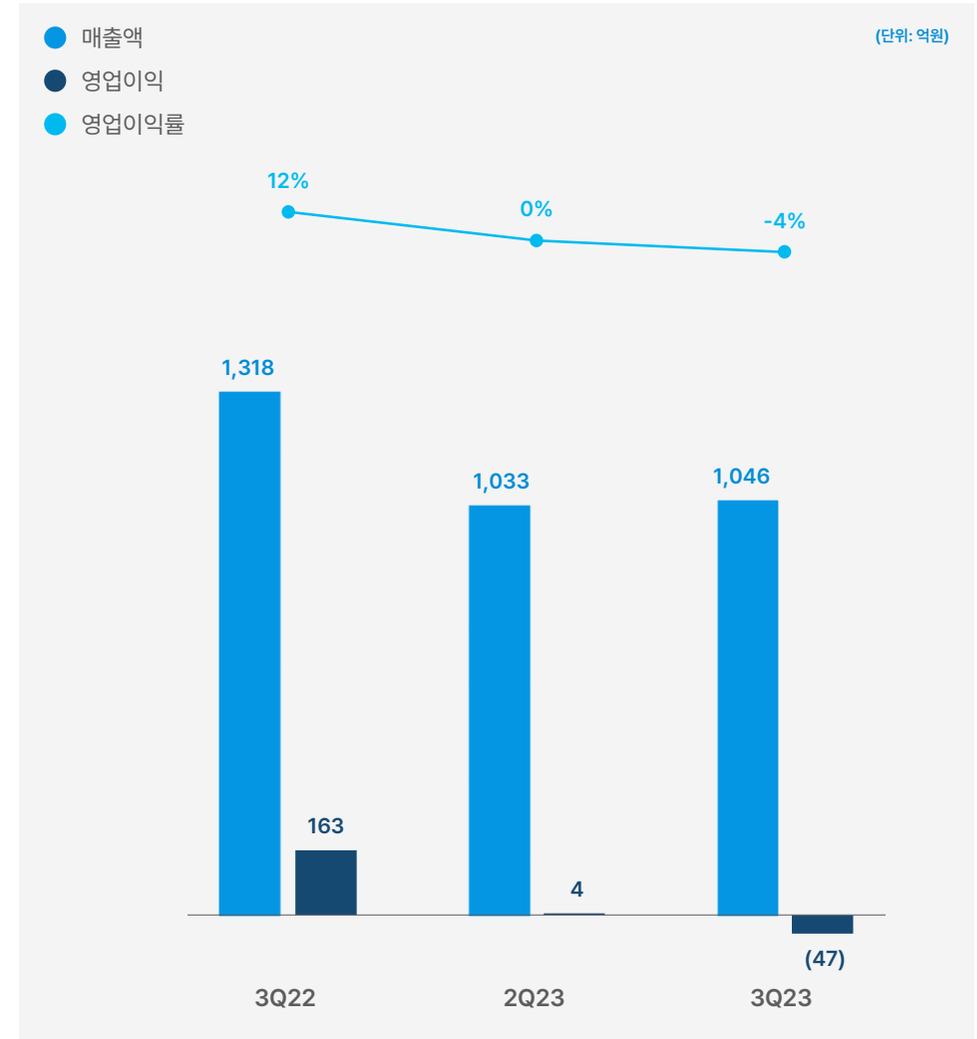
목차로 이동

# Financial Highlights

a. 공정별 매출



b. 영업이익



## Financial Highlights

### c. 분기별 실적 비교(별도)

(단위: 억원, %, %p)

구분	3Q22	2Q23	3Q23	QoQ	YoY
매출액	857	602	595	-1%	-31%
매출원가	649	555	586	+6%	-10%
매출총이익	208	47	9	-81%	-96%
이익률	24%	8%	2%	-6%p	-23%p
판관비 등	49	40	50	+26%	+2%
영업이익(손실)	159	7	(41)	-666%	-126%
이익률	19%	1%	-7%	-8%p	-25%p
EBITDA	327	187	136	-27%	-58%
마진률	38%	31%	23%	-8%p	-15%p
법인세차감전이익	138	(26)	(62)	-139%	-145%
당기순이익(손실)	110	(22)	(60)	-171%	-155%
이익률	13%	-4%	-10%	-6%p	-23%p

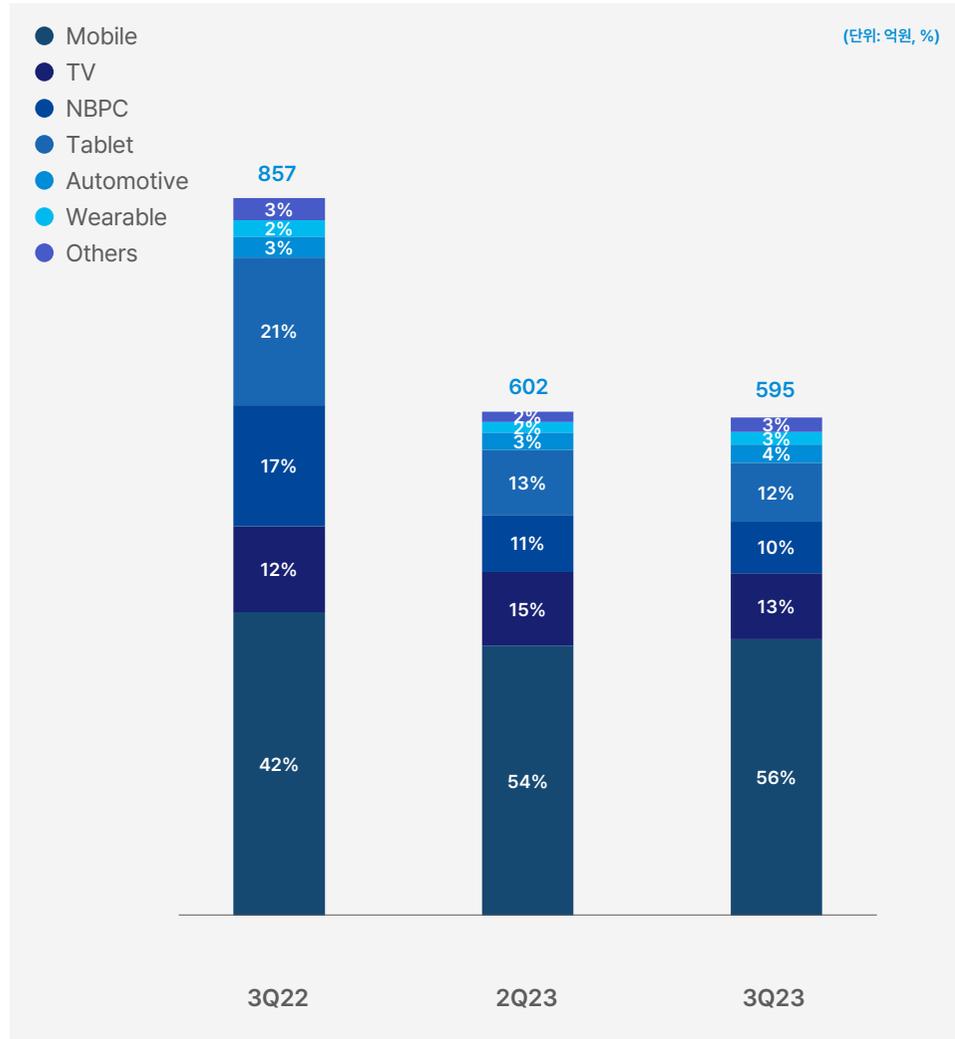
### d. 분기별 실적 비교(연결)

(단위: 억원, %, %p)

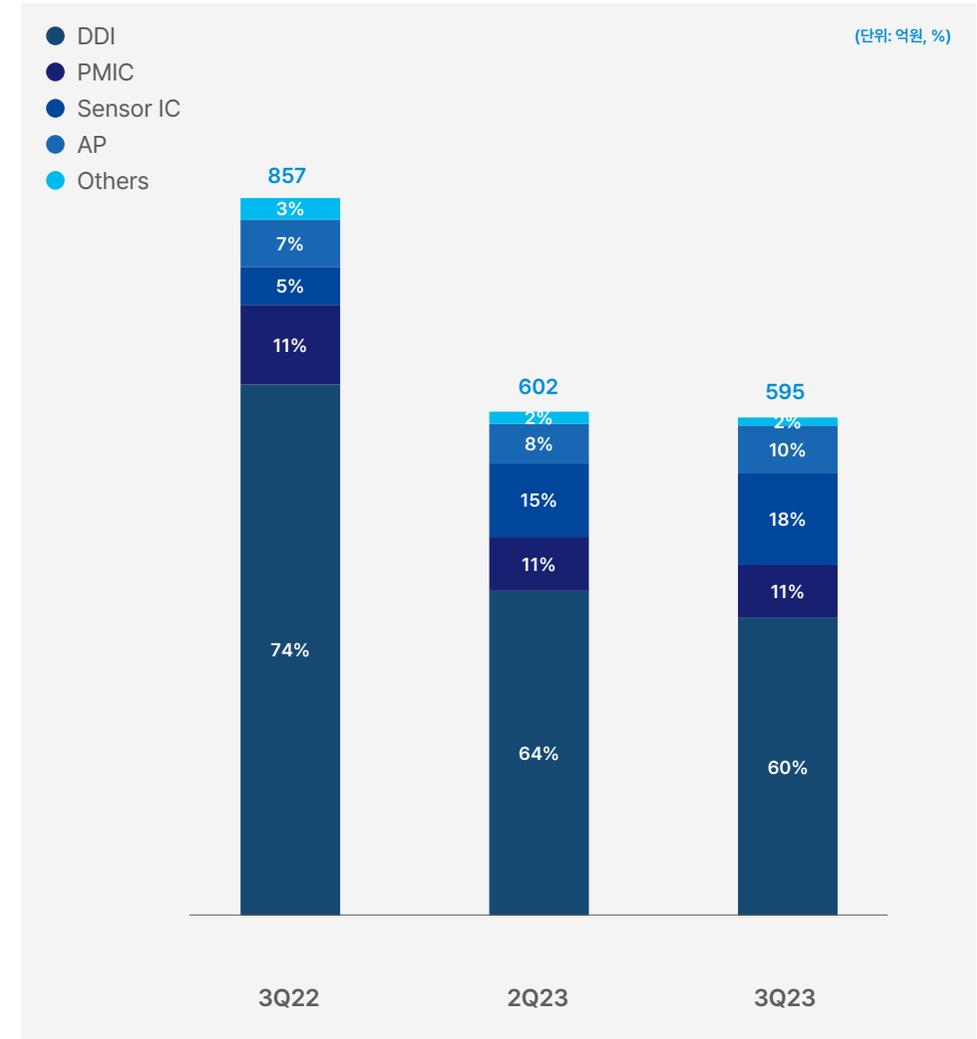
구분	3Q22	2Q23	3Q23	QoQ	YoY
매출액	1,318	1,033	1,046	+1%	-21%
매출원가	1,074	956	1,006	+5%	-6%
매출총이익	245	77	39	-49%	-84%
이익률	19%	7%	4%	-4%p	-15%p
판관비 등	81	73	86	+18%	+6%
영업이익(손실)	163	4	(47)	-1,235%	-129%
이익률	12%	0%	-4%	-5%p	-17%p
EBITDA	390	242	190	-22%	-51%
마진률	30%	23%	18%	-5%p	-11%p
법인세차감전이익	156	(23)	(58)	-155%	-137%
당기순이익(손실)	120	(20)	(60)	-197%	-150%
이익률	9%	-2%	-6%	-4%p	-15%p

# Financial Highlights

e. Application별 매출(별도)



f. 제품별 매출(별도)





## 5. Appendix

### Summary of Financial Statements

a. 별도 재무상태표	24
b. 별도 손익계산서	25
c. 연결 재무상태표	26
d. 연결 손익계산서	27

목차로 이동

## Summary of Financial Statements



### a. 별도 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2022				2023		
	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30
유동자산	797	894	1,036	925	715	929	847
비유동자산	4,648	4,664	4,692	4,900	5,024	4,907	5,105
<b>자산총계</b>	<b>5,445</b>	<b>5,558</b>	<b>5,728</b>	<b>5,825</b>	<b>5,738</b>	<b>5,836</b>	<b>5,952</b>
유동부채	1,696	1,737	1,801	1,865	1,832	1,777	2,134
비유동부채	1,750	1,723	1,719	1,663	1,657	1,832	1,652
<b>부채총계</b>	<b>3,446</b>	<b>3,460</b>	<b>3,520</b>	<b>3,527</b>	<b>3,489</b>	<b>3,609</b>	<b>3,786</b>
자본금	219	219	219	219	219	219	219
기타자본 구성요소	26	26	26	26	26	26	26
이익잉여금	1,418	1,518	1,627	1,717	1,669	1,646	1,585
<b>자본총계</b>	<b>1,998</b>	<b>2,098</b>	<b>2,208</b>	<b>2,297</b>	<b>2,249</b>	<b>2,227</b>	<b>2,166</b>

# Summary of Financial Statements



## b. 별도 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2022				합계	2023		
	2022 1Q	2022 2Q	2022 3Q	2022 4Q		2023 1Q	2023 2Q	2023 3Q
매출액	732	823	857	823	3,235	547	602	595
매출원가	582	630	649	678	2,540	543	555	586
<b>매출총이익</b>	<b>150</b>	<b>192</b>	<b>208</b>	<b>144</b>	<b>695</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>9</b>
판관비 등	41	56	49	65	211	40	40	50
<b>영업이익(손실)</b>	<b>109</b>	<b>136</b>	<b>159</b>	<b>80</b>	<b>484</b>	<b>(36)</b>	<b>7</b>	<b>(41)</b>
영업외수익	40	69	117	(77)	148	33	64	26
영업외비용	48	78	138	(66)	197	68	97	46
<b>법인세차감전이익(손실)</b>	<b>102</b>	<b>127</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>435</b>	<b>(72)</b>	<b>(26)</b>	<b>(62)</b>
법인세비용	1	27	28	2	58	(23)	(4)	(1)
<b>당기순이익(손실)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>67</b>	<b>377</b>	<b>(48)</b>	<b>(22)</b>	<b>(60)</b>

## Summary of Financial Statements



### c. 연결 재무상태표

(단위: 억원)

구분	2022				2023		
	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30
유동자산	2,382	2,387	2,415	2,073	1,915	2,073	2,096
비유동자산	5,148	5,171	5,226	5,598	5,678	5,564	5,832
<b>자산총계</b>	<b>7,531</b>	<b>7,558</b>	<b>7,641</b>	<b>7,671</b>	<b>7,593</b>	<b>7,638</b>	<b>7,928</b>
유동부채	2,256	2,172	2,137	2,164	2,144	2,033	2,512
비유동부채	1,799	1,758	1,755	1,696	1,691	1,866	1,710
<b>부채총계</b>	<b>4,055</b>	<b>3,931</b>	<b>3,892</b>	<b>3,859</b>	<b>3,834</b>	<b>3,899</b>	<b>4,222</b>
자본금	219	219	219	219	219	219	219
기타자본 구성요소	26	26	26	26	26	26	26
이익잉여금	1,562	1,682	1,795	1,871	1,821	1,799	1,738
비지배지분	1,096	1,127	1,136	1,122	1,120	1,122	1,150
<b>자본총계</b>	<b>3,476</b>	<b>3,627</b>	<b>3,749</b>	<b>3,811</b>	<b>3,759</b>	<b>3,739</b>	<b>3,706</b>

## Summary of Financial Statements



### d. 연결 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2022				합계	2023		
	2022 1Q	2022 2Q	2022 3Q	2022 4Q		2023 1Q	2023 2Q	2023 3Q
매출액	1,327	1,446	1,318	1,154	5,246	948	1,033	1,046
매출원가	1,085	1,157	1,074	1,020	4,336	931	956	1,006
<b>매출총이익</b>	<b>242</b>	<b>289</b>	<b>245</b>	<b>135</b>	<b>910</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>39</b>
판관비 등	73	90	81	98	342	69	73	86
<b>영업이익(손실)</b>	<b>170</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	<b>37</b>	<b>568</b>	<b>(52)</b>	<b>4</b>	<b>(47)</b>
영업외수익	42	79	132	(71)	182	46	72	37
영업외비용	49	79	139	(55)	211	70	99	49
<b>법인세차감전이익(손실)</b>	<b>163</b>	<b>199</b>	<b>156</b>	<b>21</b>	<b>538</b>	<b>(77)</b>	<b>(23)</b>	<b>(58)</b>
법인세비용	22	49	36	(15)	91	(24)	(3)	(2)
<b>당기순이익(손실)</b>	<b>141</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>37</b>	<b>447</b>	<b>(53)</b>	<b>(20)</b>	<b>(60)</b>
지배지분순이익	115	121	113	53	402	(50)	(22)	(61)
비지배지분순이익	26	29	7	(16)	45	(2)	2	1



**LB**Semicon

[www.lbsemicon.com](http://www.lbsemicon.com)

LB세미콘 주식회사 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 T 031-680-1600 F 031-680-1798

© 2023. LB Semicon. All rights reserved.

